

トランスクリプト

司会：冒頭のあいさつ

それでは、お時間となりましたので、東京エレクトロン株式会社 2023年3月期の決算説明会を開催いたします。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。わたくし、司会進行を務めます、IR室の八田です。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の出席者の紹介をいたします。代表取締役社長・CEO 河合 利樹でございます。

河合：河合でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、執行役員ファイナンス担当 川本 弘でございます。

川本：川本でございます。本日はよろしくお願いいたします。

プレゼンテーションに先立ち、私から、本日の会の流れについてご説明させていただきます。これより、川本、河合のプレゼンテーションをお聞きいただきます。その後 18:30 まで、質疑応答のお時間を設け、皆さまからのご質問をお受けしたいと思っております。本説明会は、Webex を 2 回線使い、日英の同時通訳でおこなっております。先日、メールでご案内させていただいたとおり、音声のみお聞きになりたい方は、電話でもご参加いただけますが、ご質問されたい方は、PC もしくはモバイル端末のアプリをお使いください。また、本説明会は機関投資家さま・アナリストさま向けの説明会となっております。大変申し訳ございませんが、回答は、従来どおり機関投資家・アナリストの方々のご質問に限らせていただきます。本説明会につきましては、後日、日英の音声配信を HP 上に掲載いたしますので、こちらも併せてご利用ください。

それでは、はじめに、執行役員 川本より、「連結決算の概要」についてご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

本決算 連結決算の概要

川本 弘（執行役員 ファイナンスユニット GM）

FY2023（2022年4月～2023年3月）財務ハイライト：スライド 4

川本のほうから 2023年3月期の業績についてまず初めにご説明申し上げます。

まず初めに業績でございますけれども、ご覧になっていただいておりますグラフは、左側が売上、真ん中が営業利益、右側が純利益、またそれぞれ売上総利益率、営業利益率、ROE を示しております。左側の売上高でございますが、メモリ向け投資につきましては年後半から減速がございましたが、ロジック/ファウンドリ向けは、最先端から成熟世代まで広い範囲での投資が継続いたしました。その結果、売上高は過去最高の 2 兆 2,090 億円、前期比+10.2%の増収となりました。営業利益は 6,177 億円、右側の当期純利益は 4,715 億円となりました。こちらも過去最高記録でございます。また、ROE でございますが、右側に示しております中期経営計画の目標である”30%以上”を維持し、32.3%となりました。

損益状況：スライド 5

トランスクリプト

こちらは、損益状況のスライドでございます。売上高につきましては、繰り返しになりますが、前期比10.2%増加の2兆2,090億円となり、右側の2月9日に発表した予想を上回る着地となりました。セグメント別に見ますと、主力のSPE売上高は、前期比10.9%増加の2兆1,552億円、FPD売上高につきましては、前期比10.3%減少の536億円となっております。売上総利益率でございますが、部材の高騰やインフレの影響がございまして、前期から0.9pts減少の44.6%となりました。同様に営業利益率でございますが、成長に向けた研究開発費増の影響もあり、28.0%と、前期から1.9pts減少いたしました。なお、下の方でございますが、1株当たり当期純利益は、1,007円となりました。

損益状況（四半期）：スライド6

次に、四半期ごとの損益についてご説明いたします。赤字の部分、第4四半期の売上高は、前四半期比19.3%増加の5,582億円となりました。セグメント別ですと、SPEは、5,433億円、FPDは149億円となりました。また、売上総利益は2,516億円、営業利益は1,527億円となりました。売上総利益率、営業利益率は直近の前四半期から売上が増加したことに伴い、製造経費率および販管費比率などが減少し、それぞれ売上総利益率は1.5pts増加の45.1%、営業利益率は2.9pts増加の27.4%となりました。なお、下の方でございますが、設備投資額が増えておりますが、これは評価用装置や現在建設中建屋の仮勘定の計上などの要因により、前四半期から増加したものでございます。

セグメント情報：スライド7

続きまして、セグメント情報について、簡単に触れさせていただきます。主力のSPEにおきましては、売上高2兆1,552億円、セグメント利益6,963億円、セグメントの利益率は32.3%となりました。FPDにつきましては、売上高536億円、セグメント利益は10億円となりました。インクジェット装置の開発中止に伴い、評価損の計上をおこなったため、セグメント利益率は前期比4.5pts減少となりました。売上構成比は、主力のSPEが98%、FPDが2%となっております。

SPE部門 新規装置 製品別売上構成比：スライド8

こちらは、SPE部門の新規装置の製品別売上構成比の推移になります。お客さまの投資ミックスの変化に伴い、製品別の売上構成比の変動は多少ございますが、2023年3月期のSPE部門の新規装置売上の合計は、前期比12.9%増加の1兆6,927億円となっております。

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比：スライド9

こちらは、前ページと同様の新規装置売上を、アプリケーション別に示したものでございます。ご覧のグラフのピンク色の部分がロジック/ファウンドリ、紫色がNAND、青色がDRAMでございます。ご覧になってお分かりのとおり、ロジック/ファウンドリでは旺盛な投資を背景に売上が大きく伸びいたしました。一方、お客さまの在庫調整に伴い、メモリ向け投資は調整があり、構成比が減少しております。

フィールドソリューション売上：スライド10

続きまして、フィールドソリューションの売上でございます。2023年3月期の売上高は、前期比4.0%

トランスクリプト

増加の 4,740 億円となりました。インストールベースの増加を背景に、パーツ・サービスの売上については、前期に引き続き堅調に増加いたしました。

貸借対照表（四半期）：スライド 11

続きまして、バランスシートについて簡単に触れさせていただきます。2023年3月末の資産合計は、2兆3,115億円。現金同等物は、4,731億円。直近から850億円の増加でございます。売上債権及び契約資産は、4,648億円。棚卸資産は6,522億円となりました。左の下の方にございますけれども、投資その他の資産は保有する株式の時価上昇などにより、前四半期から584億円増加し、2,829億円となりました。右側が負債・純資産でございます。上の負債でございますが、賞与引当金、未払法人税などの増加により前四半期から537億円増加し7,120億円となりました。純資産につきましては、剰余金の増加により1兆5,995億円となっております。なお自己資本比率は68.7%と、引き続き高い水準を維持しております。

キャッシュ・フロー：スライド 12

最後になりますが、「キャッシュ・フロー」についてご報告いたします。第4四半期の営業キャッシュ・フローは、主に売上増による利益計上により、プラスの1,096億円となりました。投資キャッシュ・フローは、設備投資の支出などにより231億円の支出。この結果、フリーキャッシュ・フローは、865億円の創出となっております。以上簡単ではございますが、2023年3月期の連結決算の概要をご報告いたしました。

司会：次のプレゼンテーションの紹介

それでは、続きまして、CEO 河合より、「事業環境および業績予想」について、ご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

事業環境および業績予想

河合 利樹（代表取締役社長・CEO）

皆さん、こんにちは。河合でございます。私の方から「事業環境および業績予想」についてご報告申し上げます。

FY2023 事業ハイライト：スライド 14

まず、FY2023 通期の事業ハイライトにつきまして、ご説明申し上げます。先ほど、川本から報告いたしましたとおり FY2023 は、売上高、利益額、ともに過去最高を更新しました。そのような中、将来の成長を見据え、過去最大となる1,911億円の研究開発投資も実施しております。事業においては、付加価値の高い戦略製品で、POR、装置選定を順調に獲得し、昨年6月に策定した中期経営計画の達成に向け、着実に進捗しております。特に、注力しております戦略工程である HARC エッチングにおいて、複

トランスクリプト

数のお客さまから開発 POR を獲得。また、成膜装置でも、NAND 向けメタル新材料の開発 POR を獲得しました。さらに、枚葉洗浄装置では、適用工程の拡大が順調に進んでおります。また、今後成長が見込まれる、MAGIC 市場、すなわち、Metaverse、Autonomous Mobility、Green Energy、IoT & Information、Communications などの市場対応強化に向けて、DSS BU を発足しましたが、4 月より始動しております。

FY2023 ハイライト新ビジョンおよび中期経営計画の策定：スライド 15

また、本年、創立 60 周年を迎えるにあたり、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」というビジョンを策定しました。デジタル化の進展と、地球環境保全に向けた脱炭素社会の両立が世界の共有価値となる中、半導体の技術革新が重要となっています。当社は、業界のリーディングカンパニーとして培った専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指してまいります。そのマイルストーンとして、ご覧のとおり、財務目標を掲げるとともに、Net Zero への取り組みを宣言しました。「夢のある社会の発展」に不可欠な存在として、半導体の重要性が一段と増す中、当社は、半導体の技術革新に貢献するという TEL's Shared Value の考えに基づき、事業活動を展開してまいります。

事業環境（2023年5月時点での見方）：スライド 16

次に、現在の事業環境について、ご説明いたします。まず、半導体市場に関しましては、さまざまな調査会社のデータを総合的に見てみますと、2023 年は昨年と比較してマイナス 10%程度と予測されていますが、2024 年には回復し、24 年の市場規模は 22 年以上に成長する見込みとなっています。本年の WFE 市場につきましては、足元のインフレに伴う、政策金利の上昇が続いていること、メモリを中心とする在庫調整の影響より、前回、2 月時点の見通しから若干下方修正し、70B~75B 程度になると見込んでいます。しかし、来年 2024 年以降の WFE 市場については、力強く成長するという見方に変更はありません。その牽引役となる、さまざまなアプリケーションや技術については、スライドに記載しているとおりでございます。データセンター向け投資の拡大、スマホ需要の回復、OS の移行に伴う PC の買い替え需要、EV/自動運転の普及、そして、また、直近話題となっている、Chat-GPT のような生成系 AI の活用などに牽引され、今後も WFE 市場は大きく拡大していくと見ております。

事業機会と注力分野（～FY2025）：スライド 17

また、これらに伴う半導体の技術革新も、一層進んでいきます。ロジックにおいては、2 nm における低消費電力・高速 CPU へのアプローチとして、GAA ナノシート、Backside PDN 構造が技術の変化の中心となります。DRAM においては、高速ワーキングメモリ DDR5 に向けて、EUV や、High-K Metal Gate が導入されます。NAND においては、大容量ストレージとしての高積層スタッキング、いよいよ 300 層へのアプローチが始まります。また、Multi-tier スタッキングや、異なるウェーハでつくったメモリセルと周辺回路を貼り合わせる技術などが採用されると期待されています。当社は、技術変化に対応した幅

トランスクリプト

広いプロダクトラインアップをもっており、特に、太字で示したようなエリアが大きな事業機会になると考えております。こうした付加価値の高い領域でシェアの拡大を目指しております。

FY2024 業績予想：スライド 18、19

次に、FY2024 の 業績予想について ご説明いたします。先ほどご説明させていただきましたとおり、マクロ経済の減速懸念などにより、足元では、半導体メーカーの設備投資は先送りや抑制の傾向にあります。このような事業環境の中、今期は固定費を低減させながらも、将来の成長を見据え、過去最大となる 2,000 億円の研究開発投資を予定しております。これらを勘案し、FY2024 は、通期で、売上高 1 兆 7,000 億円、売上総利益 7,410 億円、営業利益 3,930 億円、当期純利益 3,000 億円、となる見込みです。今後も、情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景とした半導体の技術革新、すなわち、大容量化・高速化・高信頼性・低消費電力などの重要性により、半導体製造装置市場はさらなる成長が見込まれており、FY2025 には大きく回復することを期待しております。

FY2024 SPE 新規装置売上予想：スライド 20

次に、FY2024 の SPE 新規装置の売上予想についてご説明します。ご覧のとおり、上期は 5,730 億円、下期は 6,900 億円となる見込みです。今上期に底を打ち、今下期、そして来期以降に向かって、回復すると予想しています。

FY2024 研究開発費・設備投資計画：スライド 21

次に、研究開発費と設備投資の計画です。FY2024 は、いずれも過去最高となる見通しで、研究開発費は、2,000 億円、設備投資は、1,240 億円を計画しています。また、減価償却費につきましては、570 億円を見込んでおります。設備投資に関しましては、今期、増加する計画ですが、ご覧のとおり、山梨、岩手、熊本、宮城における研究開発棟や物流センターなど、将来の事業拡大に備えたものでございます。拡大する市場と多様化する最新の技術ニーズに応えるため、積極的な研究開発と設備投資を加速してまいります。

FY2024 配当予想：スライド 22

次に、配当予想についてです。FY2023 の年間配当金につきましては、創立 60 周年記念配当 200 円を含め、1 株当たり 1,711 円となります。当社は、2023 年 4 月 1 日付で、普通株式 1 株を 3 株に株式分割しており、2024 年 3 月期の配当に関しましては、株式分割後の金額となるため、1 株につき、通期で 320 円を予定しております。なお、ご参考までに、株式分割を考慮しない場合の年間配当金は、1 株につき、960 円となります。

自己株式の取得について：スライド 23

また、本日の取締役会において、1,200 億円を上限として自己株式を取得することを決定いたしました。当社の資本政策に則り、中長期的な利益成長を見据えた成長投資、および現状のキャッシュポジションなどを総合的に勘案し、判断いたしました。今後も機動的にバランスシート・マネジメントをおこなっ

トランスクリプト

てまいります。

総還元額：スライド 23

こちらは、総還元額の推移になります。先ほどご説明いたしました計画どおりに、自己株式が取得できた場合の今期の総還元額は、配当性向 50%に基づく配当と合わせ、2,703 億円となる見込みです。今後も株主価値の向上に努めてまいります。

私からのご報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。